

证券代码：603991

证券简称：领先股份

公告编号：2026-061

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司 关于为子公司提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
先进半导体材料（深圳）有限公司（以下简称“AMC”）	80,000 万元	0.00 万元	不适用	否
先进半导体材料（安徽）有限公司（以下简称“AMA”）	20,000 万元	0.00 万元	不适用	否
先进封装材料国际有限公司（以下简称“AAMI”）	40,000 万元	0.00 万元	不适用	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	0.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0.00
特别风险提示（如有请勾选）	☐担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☒本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足深圳市领先半导体科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司生产经营活动的顺利开展，公司及子公司拟向合并报表范围内子公司提供担保，其中为资产负债率70%以上（含）的子公司担保总额为不超过人民币4亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保总额为不超过人民币10亿元。

公司及子公司提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的子公司，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准，担保额度有效期自股东会审议通过之日起12个月。

（二）内部决策程序

公司于2026年9月24日召开第五届董事会第六次会议，审议了《关于为子公司提供担保预计的议案》，董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案，该事项尚需提交股东会审议。上述审议额度不等于公司实际的担保金额，实际担保金额应以在上述审议额度内与金融机构实际发生的金额为准。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例（%）	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司及子公司	AAMI	99.97	74.62	0.00	40,000	11.04	股东会审议通过之	否	否

							日起 12 个月		
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司及子公司	AMC	99.97	23.59	0.00	80,000	22.08	股东会审议通过之日起 12 个月	否	否
公司及子公司	AMA	99.97	32.02	0.00	20,000	5.52		否	否

注：AMC 及 AMA 系 AAMI 全资子公司。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	AAMI	控股子公司	公司持股 99.97%	-
法人	AMC	控股子公司	AAMI 持股 100%	914403007362812201
法人	AMA	控股子公司	AAMI 持股 100%	91341100MA2WP6YL0X

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月（未经审计）					2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
AAMI	885,782	660,997	224,785	172,051	20,462	848,067	636,310	211,757	286,991	13,437
AMC	140,368	33,119	107,249	103,785	3,041	143,322	34,934	108,388	177,044	4,656
AMA	106,541	34,109	72,432	28,319	-1,781	104,174	29,961	74,213	39,187	-4,290

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，有关各方尚未签订担保协议，具体担保协议将在上述额度内与银行等金融机构或其他机构协商确定，担保协议内容以实际签署的协议为准。公司将按照相关规定，根据担保进展情况履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足子公司业务发展及生产经营的需要。该担保有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年9月24日召开第五届董事会第六次会议，审议了《关于为子公司提供担保预计的议案》，董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案，该事项尚需提交股东会审议。董事会认为，为子公司提供担保是为了满足其生产经营的需要，符合公司及全体股东的利益。故董事会同意本次担保事项，并同意提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 0.00 万元（包含对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 0.00%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，无逾期对外担保。

特此公告。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日